

2017年度砥粒加工学会学術講演会(ABTEC2017)
第1日目(8月30日) (*セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室	C室	D室	E室	
9:00	<p>【超音波・振動援用加工(1)】 (神 雅彦, 今井健一郎, 鈴木教和) 座長: 鈴木教和(名古屋大学) A01 アルミナセラミックスの延性モード研削加工における径方向振動援用の効果 今井健一郎(神奈川工科大学)</p>	<p>【超砥粒砥石・高機能砥石の開発と応用】 (澁谷秀雄, 澤 武一, 山口桂司) 座長: 澁谷秀雄(久留米工業大学) B01 鉄道レールの全断面削正装置の開発 第4報: レール研削面の残留応力 家口 心(宮城県産業技術総合センター), 鈴木紀彦, 佐々木 亨(仙建工業), 今野啓輝, 小松良知(大研工業), 阿部貞雄(軌道技研), 須賀久隆(ノリタケカンパニーリミテド)</p>	<p>【精密計測技術】 (清水裕樹, 村上 洋, 林 照剛) 座長: 伊東 聡(富山県立大学) C01 蛍光ナノプローブを用いたナノ粒子粒径計測システムの開発 林 照剛, 世利俊樹, 黒河周平, 松川洋二(九州大学)</p>	<p>【環境調和型加工技術(含, MQL)】 (二ノ宮 進一, 大西 孝, 西川尚宏) 座長: 西川尚宏(岩手大学) D01 高機能マイクロ・ナノパブルクーラントの研究 岩井 学, 神谷和秀, 石坂達也(富山県立大学), 二ノ宮進一(日本工業大学), 野田大輔(コモンTC), 鈴木 清(鈴木清新加工技術研究所)</p>	<p>【工具技術と切削加工技術】 座長: 黒河周平(九州大学) E01 ナノファイバー不織布を用いたバフ加工の研磨特性 呉 魏, 青山栄一, 廣垣俊樹(同志社大学), 池ヶ谷守彦, 越前谷孝嗣, 曾田浩義(エム・テックス)</p>	9:00
9:20	<p>A02 セラミックスのホーニング仕上げ面性状に及ぼす超音波振動の影響 渡邊友貴, 水谷秀行(中部大学), 大江裕之(日進製作所), 浜田晴司(多賀電気)</p>	<p>B02 光ファイバの光学研磨のための熱可塑性樹脂パッドの研究 佐賀 渉, 奈良健太, 鹿野祐樹(東北学院大学), 國枝泰博(ファーストクラスライド), 松浦 寛(東北学院大学)</p>	<p>C02 微細三次元形状測定用極小径光ファイバプローブの製作 内山晃介, 村上 洋(北九州市立大学), 甲本昭雄, 佐島隆生(九州大学), 山本隆彦, 永田良介(稲築サイエンス), 藤吉国孝(福岡県工業技術センター), 宮國健司, 青木響也(北九州市立大学)</p>	<p>D02 電気防錆加工システムの研究開発 一水加工システムの効果と実用化への発展検討一 西川尚宏(岩手大学), 澤 武一(芝浦工業大学), 吉原信人, 萩原義裕, 水野雅裕(岩手大学), 塚本真也(中国職業能力開発大学校)</p>	<p>E02 微細構造を切れ刃稜線に有するダイヤモンド工具によるソーダライムガラスの正面旋削 大野威徳(帝京大学)</p>	9:20
9:40	<p>A03 サファイアウエハのロータリ研削における砥石揺動効果に関する研究 数野真大, 楠山純平, 北嶋孝之, 由井明紀(防衛大学校), 伊東利洋(岡本工作機械製作所)</p>	<p>B03 複合砥粒砥石によるSiCの定圧研削 目片萌絵, 太田 稔, 江頭 快, 山口桂司(京都工芸繊維大学), 山田正良, 糸井正弘(日進製作所)</p>	<p>C03 エパネット光を応用した非接触式工具先端計測法に関する研究 測定精度向上の試み 井上智輝, カチョーンルンアン パナート, 鈴木恵友, シンソンブン カウイー(九州工業大学)</p>	<p>D03 砥石回転を利用したマイクロパブルクーラント発生機構に関する研究 邱 駿皓, ニノ宮進一, 山田庸二(日本工業大学), 岩井 学(富山県立大学), 鈴木 清(鈴木清新加工技術研究所)</p>	<p>E03 ダブルバイトによる条痕制御切削加工技術 篠崎 烈, 坂本武司(有明高専)</p>	9:40
10:00	<p>A04 高硬度脆性材料の超音波研削加工に関する基礎的研究 第2報: サファイアの研削 神 雅彦(日本工業大学), 金井秀生(industria)</p>	<p>B04 難削材研削加工用超砥粒ホイールの開発 小嶋孝志, 加藤展宏, 諸戸隆幸(豊田バンモップス)</p>	<p>C04 マイクロプローブのその場校正法を用いたマイクロスリット溝幅の精密測定 伊東 聡(富山県立大学), 陳 遠流, 菊地浩貴, 小林 遼, 清水裕樹, 高 偉(東北大学)</p>	<p>D04 水路内沈降分離を利用した水溶性加工液の浄化に関する研究 一加工液中に含まれる懸濁物質の回収・分級装置の開発一 古賀文雄, 邱 駿皓, ニノ宮進一(日本工業大学), 岩井 学(富山県立大学)</p>	<p>E04 繰返し押付け試験によるDLC膜の強度評価 押付け速度の影響 中村守正, 高川祐加(京都工芸繊維大学), 三浦健一, 小島淳平, 長瀧敬行(大阪産業技術研究所)</p>	10:00
10:20	***** 休憩 *****					10:20
10:40	<p>【超音波・振動援用加工(2)】 座長: 今井健一郎(神奈川工科大学) A05 超音波援用切削による機能性テクスチャリングの創成 嶋田慶太(東北大学), 平井拓弥(アイシン精機), 水谷正義, 厨川常元(東北大学)</p>	<p>【高性能切削工具の開発と応用(1)】 (村上良彦, 矢部和寿, 原田高志) 座長: 原田高志(住友電工) B05 ひびり振動を回避する多段インデックスブルエンドミルのピッチ角設計 鈴木教和, 森田知樹, 社本英二(名古屋大学)</p>	<p>【超精密加工装置と超精密加工技術(1)】 (鈴木浩文, 福田将彦, 森田晋也) 座長: 森田晋也(東京電機大学) C05 単結晶ダイヤモンド製マイクロフライス工具によるSiC製マイクロ型の超精密切削 浅井 渉, 鈴木浩文, 岡田 睦, 升田裕樹(中部大学), 藤井一二, 伊藤洋介, 岡田浩一(日進工具)</p>	<p>【加工機械の高性能・高機能化(1)】 (由井明紀, 三浦弘幸, 廣垣俊樹) 座長: 由井明紀(防衛大学校) D05 流体軸受の動力低減に関する研究 大和宏樹, 杉本 太, 平野 稔, 岩井英樹(ジェイテクト)</p>	<p>【砥粒加工技術】 座長: 細川 晃(金沢大学) E05 鏡面切断用固定砥粒工具の提案 上村康幸, 土屋健介(東京大学)</p>	10:40
11:00	<p>A06 金属加工用超音波振動切削鉋(かんな)の試作 第2報: 加工条件と加工精度との関係 神 雅彦, 佐藤準太郎(日本工業大学),</p>	<p>B06 小径ドリルを用いた鉛フリー真鍮の穴あけ加工に関する研究 添加剤の含有量の違いが切削特性に及ぼす影響 山村拓己, 加藤秀治(金沢工業大学), 岡 尚之(三菱伸銅)</p>	<p>C06 ナノ多結晶ダイヤモンド製マイクロフライス工具によるSiCの超精密切削 鈴木浩文, 浅井 渉, 岡田 睦(中部大学), 角谷 均, 原野佳津子(住友電工)</p>	<p>D06 高精度円筒研削加工に関する研究 第3報: 砥石台の新位置決め精度向上技術の検討 向井良平, 牧内 明, 高橋宏美, 近藤貞則, 佐藤友紀(豊幸), 清水伸二(MAMTEC)</p>	<p>E06 ベルト研削における砥粒分散性のエントロピー的評価(第2報) 功刀壮崇, 孕石泰文, 清水 毅, 萩原親作(山梨大学)</p>	11:00
11:20	<p>A07 超音波振動を援用した小径ドリル加工に関する研究第3報: 穴加工壁面の表面粗さ推定 米山 陽(山梨県産業技術センター), 清水 毅(山梨大学)</p>	<p>B07 ポリンドープダイヤモンドを利用したPCD工具による難加工材の切削加工 第2報: 樹脂加工用工具への適用 内山文宏(内山刃物), 岩井 学, 萩本幸恵(富山県立大学), ニノ宮進一, 古賀文雄(日本工業大学), 鈴木清(鈴木清新加工技術研究所)</p>	<p>C07 PCD工具の精密研削 一研削方向による加工特性への影響一 秋山裕亮, 鈴木浩文, 岡田 睦, 升田裕樹(中部大学), 福西利夫, 浅井義之, 小笠原規幸, 飯澤一馬(三星ダイヤモンド工業)</p>	<p>D07 無線多機能ホルダによるタップおよびエンドミル工具の回転方向振動モニタと現象解明 松田 亮, 新堂正俊(山本金属製作所), 廣垣俊樹, 青山栄一(同志社大学)</p>	<p>E07 静電植毛法を用いた研削工具の開発と性能評価 天野一哉, 孕石泰文, 萩原親作(山梨大学)</p>	11:20
11:40	<p>A08 超音波スピンドルによるPCDの超音波放電加工 長倉智史, ニノ宮進一(日本工業大学), 古賀文雄(古賀), 岩井 学(富山県立大学), 鈴木 清(鈴木清新加工技術研究所)</p>			<p>D08 工作機械の高剛性可変予圧主軸の開発 柴原豪紀, 熊谷幹人, 大西賢治(OKK)</p>	<p>E08 レジンダイヤモンドワイヤによるラップレスライスの実現 釜堀 智広(ジャパンファインスチール)</p>	11:40
12:00	***** 昼食 *****					12:00

パネル展示・研究公開・カタログ展示

13:00	我が社の新技術発表会 (D25,D37)					パネル展示・研究公開・カタログ展示	13:00
14:40	***** 休憩 *****						14:40
15:00	A09 【超音波・振動援用加工(3)】 座長：神 雅彦 (日本工業大学) 超音波振動によるラッピングテープの研磨特性の再生 第一報 目づまり除去方法の検証 磯部浩巳 (長岡技術科学大学)	B09 【高性能切削工具の開発と応用(2)】 座長：岩井 学 (富山県立大学) ナノ多結晶ダイヤモンド製ノーズR/バイトに対するドライエッチング 刃先が鋭利化されるメカニズム 母里壮大, 仙波卓弥, 天本祥文 (福岡工業大学), 角谷 均 (住友電気工業)	C09 【超精密加工装置と超精密加工技術(2)】 座長：鈴木浩文, 福田将彦, 森田晋也 座長：鈴木浩文 (中部大学) 光学ガラスの表面下損傷の可視化 浜川亮太, 古城直道, 山口智美, 廣岡大祐 (関西大学), 松森 昇, 棚田憲一 (ミスホ)	D09 【加工機械の高性能・高機能化(2)】 座長：三浦弘幸 (ジェイテクト) 研削盤砥石カバラーの衝突安全性に関する研究 日欧のカバラー材質の違いによる安全評価 福井拓哉, 由井明紀, 北嶋孝之 (防衛大学校)	E09 【マイクロ・ナノ加工(1)】 (松井伸介, 松村 隆, 江頭 快) 座長：江頭 快 (京都工芸繊維大学) AFM ナノ・マイクロスクラッチ加工による研磨加工特性評価 木村賢之助, 松井伸介 (千葉工業大学)		15:00
15:20	A10 Influence of flank face interference on micro/nano structure fabrication in elliptical vibration cutting 張 建国, 鈴木教和, 王 義龍, 社本英二 (名古屋大学)	B10 ナノ多結晶ダイヤモンド/cBN 工具材料の更なる微細化と強度特性向上 角谷 均, 石田 雄, 濱木健成, 原野佳津子 (住友電気工業)	C10 超精密加工機におけるスケール信号分岐を用いた多軸同時制御による三次元空間軌跡精度評価 段 昊, 森田晋也 (東京電機大学), 山形 豊, 細晶拓也, 竹田真宏 (理化学研究所)	D10 真空研磨装置の開発 坂本武司, 篠崎 烈 (有明工業高等専門学校), 峠 睦 (熊本大学)	E10 小型研磨機によるGaNの研磨加工特性の評価 -アルカリ液と紫外線照射の効果- 藤野雄大, 松井伸介, 遠藤謙人 (千葉工業大学), 矢島利康, 二宮大輔 (丸石産業), 山本栄一, 伊藤利洋 (岡本工作機械製作所)		15:20
15:40	A11 超音波加工装置による超音波加工作用について 岳 義弘 (岳将)	B11 新強度試験法による超硬質材料の工具特性評価 濱木健成, 石田 雄, 原野佳津子, 角谷 均 (住友電気工業)	C11 タッチプローブによる高精度幾何学形状測定に関する検討 石川絵美子, 田邊耕平, 室伏 勇, 福田将彦 (東芝機械)	D11 高能率加工, 高機能化を実現する「研削革命」 吉田 裕 (岡本工作機械製作所)	E11 集束イオンビーム照射した単結晶ダイヤモンド工具の改質とその切削加工特性 第4報: テクスタによる効果の加工条件依存性 川塚宣隆 (富山県工業技術センター), 川島拓実 (富山大学), 森田 昇 (千葉大学), 西村一仁 (工学院大学), 山口 誠 (秋田大学), 高野 登 (富山大学)		15:40
16:00	A12 超音波ミリング加工によるアクリル樹脂の鏡面切削仕上げ 原 圭祐, 井上俊太郎 (一関工業高等専門学校)	B12 導電性ダイヤモンド原料PCDのワイヤカット放電成形特性 二ノ宮進一, 長倉智史 (日本工業大学), 岩井 学 (富山県立大学), 鈴木 清 (鈴木清新加工技術研究所)			E12 超硬合金に対するナノfp研削加工技術とマイクロレンズアレイ金型の試作 高原 均, 花田智洋, 天本祥文, 仙波卓弥 (福岡工業大学)		16:00
16:20	***** 休憩 *****						16:20
16:40	学会活性化フォーラム (α棟 4階)					16:40	
18:20	学会活性化フォーラム交流会 (レストラン OASIS)					18:20	
20:30						20:30	

2017年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2017)
第2日目(8月31日) (*セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室	C室	D室	E室		
9:00	<p>【磁界・電界砥粒制御による加工技術】 (川久保英樹, 鄒 艶華, 野村光由) 座長: 野村光由 (秋田県立大学), 池田 洋 (秋田工業高等専門学校)</p> <p>A13 MCF (磁気混合流体) 研磨におけるMCFスラリーの 長寿命化 MCFスラリーの再利用の検討および, その研磨特性の評価 牧田直也, 野村光由, 藤井達也 (秋田県立大 学), 呉 勇波 (南方科技大学)</p>		<p>【先進切削加工技術】 (関根 務, 小川圭二, 杉原達哉) 座長: 杉原達哉 (大阪大学)</p> <p>C13 超硬小径スクエアエンドミルの刃先形状に関する 実験的検討 松本有司 (関西大学)</p>				9:00
9:20	<p>A14 MCF (磁気混合流体) スラリーによる微細形状の 精密研磨 微細V溝形状の鏡面仕上げ加工 姚 宗良, 野村光由, 藤井達也 (秋田県立大 学), 呉 勇波 (南方科技大学)</p>	<p>【難削材・新素材の加工 (1)】 (静 弘生, 北嶋孝之, 太田 稔) 座長: 北嶋孝之 (防衛大学校)</p> <p>B14 TiAl合金のエンドミル加工における切削特性 竹上 学, 奥田孝一 (兵庫県立大学), 児玉敏幸 (岡山大学), 布引雅之 (兵庫県立大 学)</p>	<p>C14 高速回転スピンドルによるCFRPのマイクロドリ ル加工-加工条件が加工特性に及ぼす影響- 岩元志湧, 小川圭二 (龍谷大学), 廣垣俊樹, 青山栄一, 田端章吾 (同志社大学)</p>	<p>【プラスト・バレル加工の最前線 (1)】 (深川 仁, 嶋田慶太, 中村裕紀) 座長: 中村裕紀 (豊田高専)</p> <p>D14 乾式バレル研磨方法の研磨性能改善と新機能付 与に関する研究 新乾式バレル研磨方法 糸野文亮, 西尾壮一郎, 末旨啓朗, 平塚陽一郎, 平賀幹敏, 佐川和義 (新東工業)</p>	<p>【マイクロ・ナノ加工 (2)】 座長: 松村 隆 (東京電機大学)</p> <p>E14 ガラスの切削特性に及ぼす静水圧の影響 吉野雅彦 (東京工業大学)</p>		9:20
9:40	<p>A15 電界スラリー制御技術を用いたSiC基板の研磨 特性 池田 洋, 泉 泰秀 (秋田工業高等専門学 校), 久住 孝幸, 中村 竜太, 赤上 陽一 (秋 田県産業技術センター)</p>	<p>B15 超硬合金の放電加工層切削における工具摩耗機 構 中西亘介, 宮本 猛 (神戸市立工業高等専門学 校)</p>	<p>C15 ラジラスエンドミル加工の工具経路間隔推定法 の実験検証 関根 務 (成蹊大学), マウラダウィーラ アブドゥラハマン (東海大 学)</p>	<p>D15 プラストを用いたCFRP製吸音パネルの試作研究 と性能評価 深川 仁, 市川大稀 (岐阜大学)</p>	<p>E15 サブμmサイズの微細凸形状のホットエンボ ス加工 神藤亮平 (東京工業大学), 寺野元規 (岡山理 科大), 吉野雅彦 (東京工業大学)</p>		9:40
10:00	<p>A16 電界スラリー制御技術を用いた小径工具による 研磨加工法の開発 久住 孝幸, 越後谷 正見, 中村 竜太, 赤上 陽一 (秋田県産業技術センター)</p>	<p>B16 焼結鋼の切削特性に関する研究 橋本拓也, 細川 晃, 橋本洋平, 小谷野智広, 古本達明 (金沢大学)</p>	<p>C16 切削油材挙動に着目した CBN 工具による Inconel 718 の高速切削加工 田中晴貴, 杉原達哉, 榎本俊之 (大阪大学)</p>	<p>D16 プラストを利用したCFRPの切断加工法の開発 (その2) 熱硬化性CFRPと熱可塑性CFRPの違いな ど 深川 仁, 齋藤沙織, 丹波希代子 (岐阜大学)</p>	<p>E16 ダイヤモンド極小径研削工具によるアルミナの 微細穴あけ加工 本多亮太, 林 亮夫, 竹内万里, 江頭 快, 山口桂司, 太田 稔 (京都工芸繊維大学)</p>		10:00
10:20	<p>A17 磁気援用技術による表面残留応力の付与 川久保 英樹, 佐藤 運海 (信州大学), 村田 修一 (長野県工科短期大学校)</p>	<p>B17 PCOの固定砥粒研磨におけるUV照射の影響 北村龍太郎, 野村寛志, 太田 稔, 江頭 快, 山口桂司 (京都工芸繊維 大学), 三輪敏敬 (日産自動車), 恩地好晶, 棚田憲一 (ミズホ)</p>	<p>C17 SiO2を含まない光学ガラスの超精密切削加工 石塚 潤 (慶応義塾大学), 長澤圭祐, 三神政之 (コシナ), 岡 紀旺 (慶応義塾大 学)</p>	<p>D17 アブレイシブジェットによるマイクロ形状制御 パターンニング 深さの連続変化するヘリング ポーンジャーナル溝の加工 中前翔太, 原田真志, 児玉敏幸, 大橋一仁 (岡 山大学)</p>	<p>E17 アルミニウム合金の小径穴加工における切削特 性の検討 中井 伸, 前田幸男 (富山県立大学)</p>		10:20
10:40	***** 休憩 *****						10:40
11:00	<p>【ラッピング・ポリシング・CMPの原理と応用 (1)】 (榎本俊之, 清水 淳, 林 偉民, 鈴木恵友) 座長: 鈴木恵友 (九州工業大学)</p> <p>A18 超伝導による磁気浮上工具を用いた 加工技術 に関する研究 田中佑季, 鈴木恵友, カチヨーンルンルンアン パナート, 小田部社司 (九州工業大学)</p>	<p>【難削材・新素材の加工 (2)】 座長: 静 弘生 (静岡大学)</p> <p>B18 ダイヤモンド工具によるSiCウエハのナノ加工 に関する研究 阿部 涉, 北嶋孝之, 由井明紀 (防衛大学校)</p>	<p>【光・ビームによる加工技術 (1)】 (古本達明, 比田井洋史, 細野高史, 池野順一) 座長: 古本達明 (金沢大学)</p> <p>C18 矩形分布レーザーを用いた隅部の焼入れについて 階段形状工作物での基礎的検討 須田晃平, 小川圭二 (龍谷大学), 田邊裕貴 (滋賀県立大学), 中川平三郎 (中川加工技術 研究所), 塚田悠人 (東邦金属熱錬工業)</p>	<p>【プラスト・バレル加工の最前線 (2)】 座長: 深川 仁 (岐阜大学)</p> <p>D18 アルミニウム合金の疲労特性に及ぼす二段微粒 子ピーニングの影響 西田楓流, 中村裕紀, 清水弘弘 (豊田工業高等 専門学校), 菊池将一 (神戸大学), 南部敏一 郎 (豊田工業大学), 安藤正文 (IKKショッ ト)</p>	<p>【マイクロ・ナノ加工 (3)】 座長: 松井伸介 (千葉工業大学)</p> <p>E18 微小径線材に対するマイクロドリル切削 工具 位置決め誤差が切削過程に及ぼす影響 松村 隆, 芹沢正規 (東京電機大学)</p>		11:00
11:20	<p>A19 ミリバブルがラッピング加工のスラリー供給に 与える影響 廣川健悟, 諏訪部 仁, 石川憲一 (金沢工業大 学)</p>	<p>B19 ダイヤモンドコーティング工具によるCFRPの側 面切削加工に関する研究 工具形状の違いが工 具摩耗と切削特性に及ぼす影響 北嶋孝之, 堀内拓実, 由井明紀 (防衛大学校)</p>	<p>C19 薄板鋼のレーザー焼入れフォーミング時の予熱の 影響の考察 真鍋裕輝, 廣垣俊樹, 青山栄一 (同志社大 学), 小川圭二 (龍谷大学)</p>	<p>D19 微粒子ピーニング処理アルミニウム材へ電析し ためつき密着性の曲げ試験による評価 亀山雄高, 大月 洗, 山本裕之, 佐藤秀明, 眞保良吉 (東京都市大学)</p>	<p>E19 3段平バイトによるAl-Mg合金の超精密切削加工 における表面欠陥低減の検討 天木恵輔, 前田幸男 (富山県立大学)</p>		11:20
11:40	<p>A20 難加工基板の超音波振動アシストCMPの研究 伊藤諒平, 畠田道雄 (金沢工業大学), 岳 将士 (岳将), 石川憲一 (金沢工業大学)</p>	<p>B20 光造形法による樹脂積層板およびCFRPコンポ ジット板の穴あけ加工における実験的研究 坂本重彦, 有島敬太 (熊本大学)</p>	<p>C20 劣悪環境下を想定した研削加工におけるレーザ 援用の効果 山口 憂, 安倍拓哉, 松浦 寛 (東北学院大 学)</p>	<p>D20 Ti-Ni形状記憶合金の諸特性におよぼす微粒子 ピーニングの影響 南部敏一郎 (豊田工業大学), 江上 登 (名城 大学)</p>	<p>E20 ダクタイル鉄鍍 (FCD600) の精密切削加工におけ る工具摩耗特性の検討 鄒 雅章, 前田幸男 (富山県立大学)</p>		11:40
12:00	<p>A21 日本刀の作刀に及ぼす研磨工程の基礎科学的研 究 天然・人造砥石の機械的的特性の調査と匠の 意識調査 大井 恭, 畠田道雄, 石川憲一 (金沢工業大 学)</p>		<p>C21 Laser ablation of CFRP Epoxy from vitrified WA grinding wheels Govindaraj Gowtham, 山田啓司, 田中 隆太郎, 關谷克彦 (広島大学)</p>		<p>E21 超硬合金微細軸の旋削加工 高野英亮, 上田将大, 江頭 快, 山口桂司, 太田 稔 (京都工芸繊維大学)</p>		12:00

パネル展示・研究公開・カタログ展示

12:20	*****昼食*****	12:20
13:20	招待講演 (FITホール 3階)	13:20
14:20	*****休憩*****	14:20
14:40	30回記念特別講演 (FITホール 3階)	14:40
15:40	*****休憩*****	15:40
16:00	活動報告会・贈賞式 (FITホール 3階)	16:00
17:20	*****移動*****	17:20
18:00	懇親会 ホテル ザ・ルイガンズ	18:00
20:00		20:00

パネル展示・研究公開・カタログ展示

2017年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2017)
第3日目(9月1日) (*セッション名後はオーガナイザ名)

	A室	B室	C室	D室	E室	
9:00	A22 【ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(2)】 座長：清水 淳 (茨城大学) プラズマ処理装置による研磨砥粒高機能化の検討 金谷宜亮, 村田順二 (近畿大学)	B22 【研削現象の基礎とモニタリング(1)】 (大橋一仁, 水谷秀行, 李 和樹) 座長：李 和樹 (日本大学) 超精密研削加工されたサファイア表面の品質評価 菅野 直, 小貫哲平, 吳 柯, 尾島裕隆, 清水 淳, 周 立波 (茨城大学)	C22 【光・ビームによる加工技術(2)】 座長：山田洋平 (埼玉大学) CW-LBI法を用いた結晶化ガラス内部における金属球のレーザマニピュレーション 吉村秀行, 比田井洋史, 松坂壮太, 千葉 明, 森田 昇 (千葉大学)			9:00
9:20	A23 セリウム薄膜触媒を用いたガラスの砥粒フリー研磨における研磨特性向上 合田和樹, 村田順二 (近畿大学)	B23 半導体ウエハのロータリ研削における研削抵抗に関する研究 -加工抵抗の2成分比- 楠山純平, 由井明紀, 北嶋孝之 (防衛大学校)	C23 レーザ誘起湿式改質処理を施した純チタン材における溶液成分が改質層形成に及ぼす影響 江面篤志 (栃木県産業技術センター), 大川弘暉 (慶應義塾大学), 片平和俊 (理化学研究所), 小茂鳥 潤 (慶應義塾大学)	D23 【ナノ精密・ELID加工(1)】 (水谷 正義, 大森 整, 伊藤伸英, 片平和俊) 座長：松澤 隆 (池上金型工業) ツインシズメルPELIDを用いた砥石製作システムの構築 清水和樹, 伊藤伸英, 飯沼亮介 (茨城大学), 梅津信二郎 (早稲田大学), 大森 整 (理化学研究所)	E23 【新デバイスへの応用(1)】 (亀山雄高, 矢澤孝哲) 座長：矢澤孝哲 (長崎大学) 純チタン平面に成膜したDLGに対する搔爬について 深井森平, 佐藤秀明, 渡邊義征, 亀山雄高, 眞保良吉 (東京都市大学), 吉川亮太, 田口純志 (野村鍍金), 島内英俊, 真柳 弦, 石幡浩志 (東北大学)	9:20
9:40	A24 冷凍ピンチャックを用いた石英ガラス基板の平坦化研磨 ピン間冷却液の効果 吉富健一郎, 宇根篤暢, 餅田正秋 (防衛大学校)	B24 Investigation of Dressing Cycle Based on Variation of Grinding Forces in Cylindrical Grinding Anand Nambiar, 松本 耕, 山本 優, (シギヤ精機製作所), 大橋一仁 (岡山大学), 塚本真也 (中国職業能力開発大学校)	C24 積層造形用ダイヤモンド粉末の各種特性に関する研究 粒度分布の違いが熱伝導率およびレーザ吸収率に及ぼす影響 田辺優弥, 古本達明, 橋本洋平, 小谷野智広, 細川 晃 (金沢大学)	D24 3Dプリンタを用いたELID研削砥石の開発 益子雄行, 谷野登生, 伊藤伸英 (茨城大学), 大森 整 (理化学研究所), 梅津信二郎 (早稲田大学)	E24 サンドブラスト処理を施したチタン及びアルミニウムの細胞接着性の評価 齊藤 学, 桃沢 愛, 飯島夢生, 亀山雄高, 新井正雄 (東京都市大学)	9:40
10:00	A25 小径研磨ツールの走査による大面積表面の研磨の検討 林 偉民, 王 賀 (群馬大学)	B25 ハイレゾ研削による耐熱合金の研削 吉原信人, 宝満正嗣, 西川尚宏, 水野雅裕 (岩手大学)	C25 Powder Bed Fusion 法による金属造形物内部の気孔抑制法に関する研究 ベースプレート温度による気孔サイズや分布の変化 江頭細太, 古本達明, 菱田貴一, 橋本洋平, 小谷野智広 (金沢大学), 吉田徳雄, 中村暁史 (パナソニック), 細川 晃 (金沢大学)	D25 導電性ラバーボンド砥石を用いたELID研削におけるマイクロバブルの効果 坂田直基, 山本寛之, 伊藤伸英 (茨城大学), 大森 整 (理化学研究所), 稲澤勝史 (栃木県産業技術センター)	E25 電空ハイブリッド超精密鉛直位置決め装置の消費エネルギー測定 築山義信, 加藤友規, 中垣 瞬 (福岡工業大学)	10:00
10:20	***** 休憩 *****					10:20
10:40	A26 【ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(3)】 座長：林 偉民 (群馬大学) 摩耗率の異なる材料を利用した形状発現型ポリッシングパッドの開発 第1報：ナイロン繊維とウレタン樹脂を用いたパッドの作製法の開発 鬼木喬玄 (九州工業大学, 三島光産), 加藤侑也, カチヨーンルンルアン パナート, 鈴木恵友 (九州工業大学), 田代康典, 松尾正昭 (三島光産)	B26 【研削現象の基礎とモニタリング(2)】 座長：大橋一仁 (岡山大学) 多糸ドレス方法とその研削効果 市原浩一 (住友重機械工業)	C26 【R. 光・ビームによる加工技術(3)】 座長：比田井洋史 (千葉大学) フォトニックナノジェットの強度分布制御と位置制御による微細加工に関する研究 上野原 努, 高谷裕浩, 水谷康弘 (大阪大学)	D26 【ナノ精密・ELID加工(2)】 座長：水谷正義 (東北大学) 高硬度鉄めっき砥石の開発とその加工特性 第2報：微細砥粒の適用 大野裕平, 伊藤伸英 (茨城大学), 大森 整, 加藤照子 (理化学研究所), 松澤 隆 (池上金型工業), 稲澤勝史 (栃木県産業技術センター)	E26 【新デバイスへの応用(2)】 座長：亀山雄高 (東京都市大学) 培養面温度制御が可能な細胞培養デバイスの構築とその性能評価 井田雄太, 倉科佑太, 宮田昌悟, 小茂鳥 潤 (慶應義塾大学)	10:40
11:00	A27 サファイアCMPIにおける水酸化フラーレン吸着型微粒子に関する研究 吉本 裕, 鈴木恵友 (九州工業大学)	B27 高速度カメラを用いた砥石表面状態の定量的評価 内田元, 小林聖和, 平野育海, 桑原拓実, 李 和樹, 山田高三, 三浦浩一 (日本大学)	C27 フェムト秒レーザーによる半導体表面の光励起加工 林 照剛, 松永啓伍, 黒河周平, 松川洋二 (九州大学)	D27 ナノカーボン含有切削液を利用した切削加工技術の開発 第1報：単結晶ダイヤモンド工具によるステンレス鋼の鏡面加工 松澤 隆 (池上金型工業), 上原嘉宏, 加藤照子, 大森 整 (理化学研究所), 伊藤伸英 (茨城大学)	E27 微細凹凸加工による沸騰熱伝達向上に関する研究 山田玲子, 中出口真治, 矢澤孝哲, 桃木 悟, 松尾肇彦, 森高秀四郎, 大坪 樹 (長崎大学)	11:00
11:20	A28 小径工具を用いたサファイア基板の高速回転研削 ディスベンサによるスラリの高圧供給 嶋田佳法, 吉富健一郎, 餅田正秋, 宇根篤暢 (防衛大学校)	B28 精密数値化された形状情報を用いたダイヤモンド砥粒の分類 菊田勝文, 小杉 剛 (グローバルダイヤモンド), 早内愛子, 笹倉大督 (スペクトリス)	C28 SiCのレーザスライシング加工に関する研究 山田洋平, 阿部達毅 (埼玉大学), 浅原浩和, 富士和則, 明田正俊 (ローム), 池野順一 (埼玉大学)	D28 半導体レーザー照射による使用済み酸化セリウム研磨材のリフレッシュ効果の検討 茂木俊樹 (ものづくり大学), 加藤照子, 大森整, 渡邊 剛 (理化学研究所), 小泉俊郎 (ラステック), 上原嘉宏, 春日 博 (理化学研究所), 堀内 勉, 平井聖児 (ものづくり大学)	E28 人工歯加工材料加工装置開発および加工メカニズムに関する研究 土肥 学, 矢澤孝哲 (長崎大学), 丸木諒祐 (THK), 森山慎也 (三井ハイテック), 黒岩 恵 (恵夢工房), 大坪 樹 (長崎大学)	11:20
11:40	A29 C面サファイア基板のナノ引っかけ 林 旺票, 清水 淳, 周 立波, 小貫哲平, 尾島裕隆, 山本武幸 (茨城大学)	B29 粒子形態情報と顕微ラマン分光法の複合解析によるダイヤモンド砥粒の物性予測に関する可能性検討 早内愛子, 笹倉大督 (スペクトリス), 小杉 剛, 菊田勝文 (グローバルダイヤモンド)	C29 ガラスの3次元レーザスライシング加工 阿部達毅, Fathin Nadia, 山田洋平, 池野順一 (埼玉大学)			11:40

パネル展示・研究公開・カタログ展示

12:00	***** 休憩 (10分) *****				12:00
12:20	奨励賞受賞記念講演 (A棟401室)				12:20
12:40	***** 昼食 *****				12:40
13:40	<p>【ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(4)】 座長：林 偉民 (群馬大学) A30 SiCの電解酸化援用砥粒フリー研磨技術における研磨特性向上 長友大樹, 合田和樹, 村田順二 (近畿大学)</p>	<p>【研削現象の基礎とモニタリング(3)】 座長：水谷秀行 (中部大学) B30 画像処理による砥石作業面の3次元解析 第10報:ダイヤモンド砥粒の光学特性を用いた解析 松本光生, 内田和志, 坂口彰浩, 川下智幸, 松尾修二 (佐世保工業高等専門学校), 中島昭二 (菱計装), 峠 直樹, 古野大樹 (ノリタケカンパニーリミテド)</p>	<p>【切断・割断加工(1)】 (諏訪部 仁, 松坂社太, 留井直子) C30 座長：諏訪部 仁 (金沢工業大学) 走査型電子顕微鏡 (SEM) を用いたガラス基板のスクライプ加工プロセスの観察 齊藤雅裕, 松本祐一郎, 松坂社太, 比田井洋史, 千葉 明, 森田 昇 (千葉大学)</p>	<p>【ツルージング・ドレッシング技術】 (久保明彦, 岩井 学, 市田良夫, 吉原信人) D30 座長：吉原信人 (岩手大学) メカノケミカル砥石を利用した単結晶シリコンの超仕上げ 目直し条件が及ぼす影響 土肥一輝, 古城直道, 山口智実, 廣岡大祐 (関西大学), 松森 舞, 棚田憲一 (ミズホ)</p>	13:40
14:00	<p>A31 燐光性粒子を励起発光剤として用いたSiCウエハの光触媒アシスト研磨法 香川将也, 村田順二 (近畿大学)</p>	<p>B31 ディーブラーニングを用いたダイヤモンド砥粒の分類 内田和志, 松本光生, 坂口彰浩, 川下智幸, 松尾修二 (佐世保工業高等専門学校)</p>	<p>C31 薄板ガラスのホイール割断における亀裂形成挙動の観察 高速度カメラを用いた試料裏面方向からの観察 今井健太郎, 齊藤雅裕, 松本祐一郎, 松坂社太, 比田井洋史, 千葉 明, 森田 昇 (千葉大学)</p>	<p>D31 cBNホールによる焼入鋼へのヘリカルスキャン溝入れ研削 岩井 学, 中島大貴 (富山県立大学), ニノ宮進一 (日本工業大学), 山田庸二 (山田マシンツール), 鈴木 清 (鈴木清新加工技術研究所)</p>	14:00
14:20	<p>A32 紫外線励起加工の研究 (第23報) 紫外線励起下における4H-SiCウエハの研磨特性(その4) 田中武司, 滝沢 優, 畑 彰宏 (立命館大学)</p>	<p>B32 ディーブラーニングを用いたダイヤモンドワイヤ表面の砥粒抽出と砥粒分散状態の統計的評価 坂口彰浩, 川下智幸, 松尾修二, 松谷茂樹, 濱田裕康, 大浦龍二 (佐世保工業高等専門学校)</p>	<p>C32 スクライプによる硬脆材料の亀裂進展挙動 留井直子, 村上健二, 橋本多市, 福西利夫 (三星ダイヤモンド工業)</p>	<p>D32 微粉ドライアイスプラストによるカーボン研削砥石の目詰まり切りくず除去法 第2報:砥石の切れ味の検討 片山雄登, 太田佑樹, 児玉紘幸, 大橋一仁 (岡山大学)</p>	14:20
14:40	***** 休憩 *****				14:40
15:00	<p>【ラッピング・ポリッシング・CMPの原理と応用(5)】 座長：鈴木恵友 (九州工業大学) A33 高能率鏡面研磨用砥粒 (MeCCA) の開発 サファイアに対する湿式研磨性能およびウエハ品質評価 藤本俊一 (アサヒ化成)</p>	<p>【研削現象の基礎とモニタリング(4)】 座長：水谷秀行 (中部大学) B33 長尺工作物の円筒トラバース研削における形状推定法 砥石軸モータ電力より推定した工作物形状 坂本晃一, 大西 孝 (岡山大学), 坂倉守昭 (大同大学), 高島哲平, 大橋一仁 (岡山大学)</p>	<p>【切断・割断加工(2)】 座長：松坂社太 (千葉大学) C33 樹脂コーティングワイヤを用いたマルチワイヤソーによるSiCの高精度切断加工に関する研究 溝田勇飛, 諏訪部 仁, 石川憲一 (金沢工業大学)</p>	<p>【加工と評価・測定技術】 座長：坂本重彦 (熊本大学) D33 切削工具刃先摩耗検知技術 佐野 靖, 西川顕二, 千葉 修 (日立製作所), 岡田 真 (日立GEニュークリア・エナジー)</p>	15:00
15:20	<p>A34 革新的プラズマ融合CMP®技術による超難加工材料の高効率加工 加工メカニズムと高効率化条件の追究 武田秀俊 (九州大学, 並木精密宝石), 土肥俊郎 (九州大学), 會田英雄 (九州大学, 長岡科学技術大学), 金 聖祐 (並木精密宝石), 白谷正治, 山西陽子 (九州大学)</p>	<p>B34 長尺円筒工作物のトラバース研削のシミュレーション解析 川口直紀, 坂倉守昭 (大同大学), 大西 孝 (岡山大学), 高島哲平 (三菱電機), 坂本晃一, 大橋一仁 (岡山大学)</p>	<p>C34 樹脂コーティングワイヤソーによるシリコンのスライシング加工 佐治季貴, 諏訪部 仁, 石川憲一 (金沢工業大学)</p>	<p>D34 長尺内面研削スピンドルの開発に関する研究 第7報、加工時の振動挙動と加工内面の幾何特性の評価 安達和彦 (中部大学), 大久保信雄, 大久保元博 (大久保精工), 向井良平, 高橋宏美 (豊幸)</p>	15:20
15:40	<p>A35 グリーンデバイス用結晶基板の加工プロセス技術の研究 加工時間短縮を実現する新しい生産性指数の提案 大坪正徳, 瀬下 清, 塚本敬一 (九州大学), 宮下忠一 (不二越機械工業), 柏田太志 (フジボウ愛媛), 山崎努 (D-process), 土肥俊郎 (九州大学)</p>	<p>B35 内面研削における砥石変形と形状精度のシミュレーション解析 横山真平, 坂倉守昭 (大同大学), 大西 孝, 西 空也, 大橋一仁 (岡山大学)</p>	<p>C35 極細線ワイヤの工具による硬脆材料の基礎的な加工特性 一対速度と工具寿命との関係一 林 敬徳, 源馬正也, 坂本 智 (横浜国立大学), 山口 真 (サレジオ工業高等専門学校), 近藤 康雄 (山形大学), 山口顕司 (米子工業高等専門学校)</p>	<p>D35 形状創成放電加工における電極消耗予測のための電極部位別消耗率の高精度測定 吉川浩一, 森 直樹, 水垣善夫 (九州工業大学)</p>	15:40
16:00					16:00

パネル展示・研究公開・カタログ展示

2017年度砥粒加工学会学術講演会 (ABTEC2017) セッションプログラム

【第1日：8月30日】

	A室	B室	C室	D室	E室	
9:00						パネル 展示・研 究公開・ カタログ 展示
9:20	超音波・振動 援用加工(1)	超砥粒砥石・ 高機能砥石の 開発と応用	精密計測技術	環境調和型加 工技術(含, MQL)	工具技術と切 削加工技術	
9:40						
10:00	休 憩					
10:20						
10:40	休 憩					
11:00	超音波・振動 援用加工(2)	高性能切削工 具の開発と応 用(1)	超精密加工装 置と超精密加 工技術(1)	加工機械の高 性能・高機能 化(1)	砥粒加工技術	
11:20						
11:40						
12:00	昼 食 (レストラン OASIS)					
13:00	我が社の新技術発表会 (D25,D37)					
14:00	休 憩					
14:40	超音波・振動 援用加工(3)	高性能切削工 具の開発と応 用(2)	超精密加工装 置と超精密加 工技術(2)	加工機械の高 性能・高機能 化(2)	マイクロ・ナ ノ加工(1)	
15:00						
16:00	休 憩					
16:20	休 憩					
16:40	学会活性化フォーラム (α棟 4階)					
18:20	学会活性化フォーラム交流会 (レストラン OASIS)					
20:00						

【第2日：8月31日】

	A室	B室	C室	D室	E室	
9:00						パネル 展示・ 研究公 開・ カタログ 展示
9:20	磁界・電界砥 粒制御による 加工技術	難削材・新素 材の加工(1)	先進切削加工 技術	プラスト・パレ ル加工の最前 線(1)	マイクロ・ナ ノ加工(2)	
9:40						
10:00	休 憩					
10:20						
10:40	休 憩					
11:00	ラッピング・ポリ シング・CMPの 原理と応用 (1)	難削材・新素 材の加工(2)	光・ビームによ る加工技術 (1)	プラスト・パレ ル加工の最前 線(2)	マイクロ・ナ ノ加工(3)	
11:20						
11:40						
12:00	昼 食 (レストラン OASIS)					
12:20	招待講演 (FITホール 3階)					
13:20	招待講演 (FITホール 3階)					
14:20	休 憩					
14:40	30回記念特別講演 (FITホール 3階)					
15:40	休 憩					
16:00	活動報告会・贈賞式 (FITホール 3階)					
17:20	移 動					
18:00	懇 親 会 ホテル ザ・ルイガンズ					
20:00						

【第3日：9月1日】

	A室	B室	C室	D室	E室	
9:00	ラッピング・ポリ シング・CMPの 原理と応用 (2)	研削現象の基 礎とモニタリ ング(1)	光・ビームによ る加工技術 (2)	ナノ精密・ELI D加工(1)	新デバイスへ の応用(1)	パネル 展示・ 研究公 開・ カタログ 展示
9:20						
9:40						
10:00	休 憩					
10:20						
10:40	休 憩					
11:00	ラッピング・ポリ シング・CMPの 原理と応用 (3)	研削現象の基 礎とモニタリ ング(2)	光・ビームによ る加工技術 (3)	ナノ精密・ELI D加工(2)	新デバイスへ の応用(2)	
11:20						
11:40						
12:00	休 憩					
12:20	奨励賞受賞記念講演 (α棟 4階)					
12:40	昼 食 (レストラン OASIS)					
13:40	ラッピング・ポリ シング・CMPの 原理と応用 (4)	研削現象の基 礎とモニタリ ング(3)	切断・割断加 工(1)	ツルーイング・ ドレッシング技 術		
14:00						
14:20						
14:40	休 憩					
15:00	ラッピング・ポリ シング・CMPの 原理と応用 (5)	研削現象の基 礎とモニタリ ング(4)	切断・割断加 工(2)	加工と評価・測 定技術		
15:20						
15:40						
16:00						